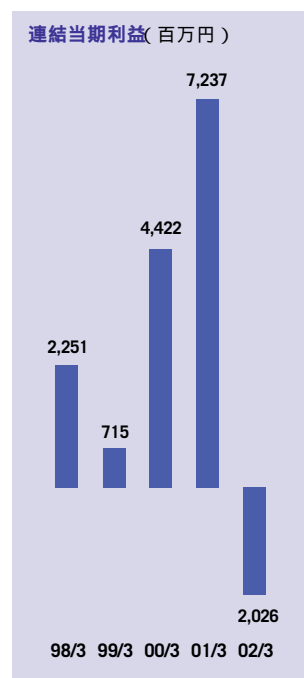
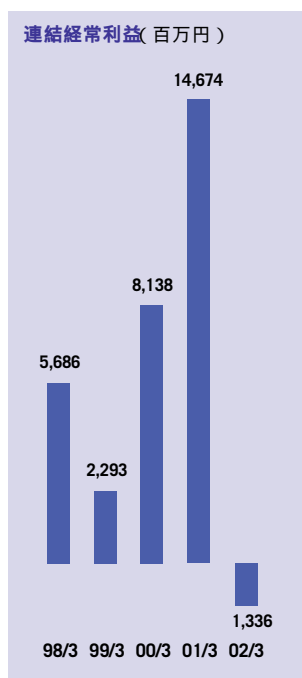
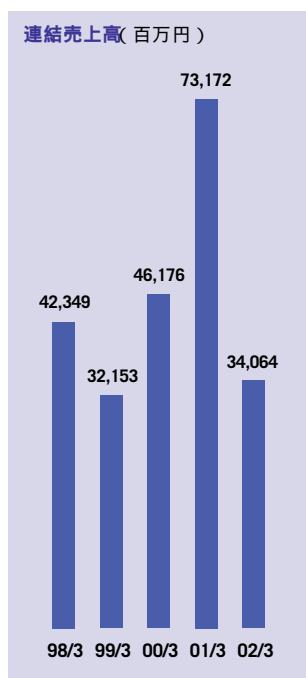


第 79 期
事業報告書



株式会社東京精密

財務ハイライト



単位:百万円

	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3	2002/3
連結売上高	42,349	32,153	46,176	73,172	34,064
連結経常利益	5,686	2,293	8,138	14,674	1,336
連結当期利益	2,251	715	4,422	7,237	2,026
連結総資産	46,163	41,309	61,007	91,477	79,865
連結純資産	27,604	28,437	33,433	38,779	35,423
発行済株式総数(千株)	36,575	37,004	37,543	37,465	37,372
1株当たり当期利益(円)	63.87	19.41	118.43	192.95	54.21

1株当たり当期利益は、期中の平均株式数により算出しています。

株主の皆様へ

東京精密の株式を保有して頂き、有難う存じます。厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、株主の皆様が当社株式を保有していただいた目的に沿った経営を目指しております。

当社は、経営指標といたしましては、一株当たりの純利益（EPS）を長期的に増大させていく事を重視しております。会社にとっては、企業価値を長期的に増大させることになり、株主の皆様のご期待に応えることになると考えます。これは当社のモットーであるWIN-WINの関係を株主の皆様と会社との間で作り上げる事につながると確信しております。

当社は、技術指向型の会社です。上記の目的のために当社は次の「製品開発の原則」に沿って技術開発を継続的に行ってまいります。

1. 世界No. 1の製品を創る。

マーケットシェアNo. 1の商品は

- (1) 好況時は、利益の極大化を図れる。
- (2) 不況時は、損失の極小化を図れる。

2. 研究開発投資は自己資金で。

3. 技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。

4. 市場規模が停滞縮小傾向にあるが、ユーザーとの関係で、今後もR&D投資が必要な製品は、競合先であってもアライアンスを組み、R&Dコストをシェアする。

この原則を守るためには、各国、各社の持つ異文化を包摂したグローバルかつハイブリッドな東京精密の文化風土を醸成しなければなりません。そこで、「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」というモットーを制定し、世界No.1の商品開発体制の構築に努めてまいりました。

さらに、昨年1月には「ACCRETECH(アクレーテック)」というコーポレートブランドを導入しました。「ACCRETECH」は、共に成長するという意味の「ACCRETE」と「TECHNOLOGY」を組み合わせた合成語で、「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して、世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく」という当社の企業理念を一語で表したものです。

株主の皆様にも是非当社の企業理念にご賛同賜り、このコーポレートブランド「ACCRETECH」のもと、更なる飛躍を目指す当社に、今後とも格別なるご理解とご支援をお願い申し上げます。



代表取締役社長
大坪 英夫

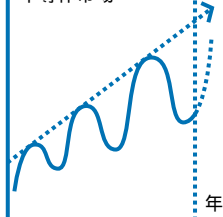
大坪英夫

QUESTION 1

半導体関連産業には、シリコンサイクルがあり、昨年、未曾有の大不況を経験したと聞いています。不況に対する東京精密の対応と現在の状況について教えてください。

シリコンサイクル

半導体市場



ANSWER 1

シリコンサイクルとは、技術革新の速さから、半導体製品のライフサイクルが非常に短く、新世代のICが登場すると価格は高騰し、十分普及すると価格は下落を始め、再び新世代のICが登場すると価格が持ち直すというもので、2～4年の

周期で繰り返される半導体産業の景気循環です。

今回の不況は、このシリコンサイクルの落ち込みに世界的な不況と米国でのテロ事件の影響等が重なり、過去に例をみない深い谷でした。しかし、現在では、シリコンサイクルは、在庫調整が進み、昨年第二四半期に底を打ち、徐々にではありますが回復基調にあります。

当社は、約10年前より市場動向に応じて製造ラインの操業度をフレキシブルに変更することを可能にするために派遣従業員とパート従業員を活用してきました。昨年度は、派遣従業員を中心とした人員削減を行うと同時に、昨年10月から半導体製造装置の生産拠点である八王子工場の稼働を月曜日から水曜日までの週3日間とし、固定費削減に努めました。その他、主要製品を中心に設計段階からの抜本的なコストの見直しを実施し、徹底したコストダウンを推進し、将来の利益を創出する努力を行いました。

一方、計測機器部門は、市況環境は厳しかったものの、比較的安定した売上と利益を確保し、会社全体としての利益の支えとなりました。

現在の当社半導体部門のビジネスは、半導体の在庫調整が進展し、受注状況も大幅に改善しており、需要の回復による生産増に対応するため、八王子工場を、4月1日から通常勤務に戻し、計測機器の生産拠点である土浦工場とともに、工場すべて通常勤務体制となりました。さらに、新製品群についても受注を獲得しています。プローバなどの半導体既存製品の立ち上がり和新製品売上の寄与によって、今後売上増加を図っていく予定です。

QUESTION 2

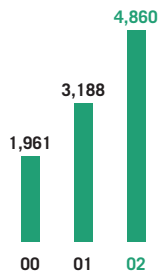
2002年3月期は営業損失17億57百万円という結果になりましたが、この要因を教えてください。

ANSWER 2

営業損失17億57百万円の内訳は、半導体製造装置部門の営業損失が38億31百万円、計測機器部門の営業利益が20億73百万円です。

全体としては営業損失になりましたが、その要因の一つとして、将来に向けての開発投資を積極的に実施したことが挙げられます。当期は、48億60百万円という既往最高レベルの大規模な研究開発投資を実施しました。研究開発投資を抑えれば、営業利益を計上しながら不況を乗り越えることも可能でした。

研究開発費(百万円)



当社は技術指向の会社で、技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野において、世界No.1の最先端の製品を常に開発することを原則としています。そして、開発した新製品をニーズに合致した時期にタイミング良く市場投入することが重要であると考えています。従って当社は、足元の景気の良し悪しにとらわれた研究開発投資ではなく、マーケットニーズのタイミングから判断して、必要とされる装置を必要な時期に市場投入できるように、研究開発投資を行っています。その結果、次期の半導体市況回復時の利益を極大化するために、この不況時においても大幅な研究開発投資を行うことを決定しました。

当期の研究開発費の大半は、当社の次期を担う次世代リソグラフィ装置「LEEPL」、CMP、ウェーハ外観検査装置に費やされています。近年これら新製品群の開発に注力しました結果、当期が開発のピークとなりました。これらの研究開発の結果が今後の当社の業績に大きく影響してくることは間違いなく、これら新製品群が成功することによって、東京精密は半導体製造装置業界において確固たるポジションを構築することになるとともに、半導体産業に大いに貢献致します。



リソグラフィ装置
「LEEPL」機



CMP装置
「A-FP-210A」



ウェーハ外観検査装置
「WIN-WIN 50」

QUESTION 3

LEEPLの開発状況について教えてください。

ANSWER 3

LEEPLとは、低エネルギーの電子ビームで半導体ウェーハ上に微細回路を転写する新しいタイプのリソグラフィ装置(露光装置)です。微細化のデザインルール100ナノメートル以下対応の次世代リソグラフィ装置に期待される、高解像度・高生産性・低価格という要素をすべてクリアした革新的な装置で、現在開発に注力しています。

開発は予定通り2001年12月に、わずか1年足らずの大変短い開発期間で 機 評価機または実証機)を完成させ、2002年3月にLEEPL技術開発・促進においてユーザーとして共同開発に参画しているソニー株式会社に出荷しました。ソニー株式会社内で、機の基本性能の評価、LEEPLリソグラフィプロセスの確立を行い、量産用装置開発へのフィードバックを行った上で、2003年3月までに量産機を完成させ、4月に市場投入する予定です。

「LEEPL技術コンソーシアム」は昨年6月15日に次世代リソグラフィ技術の開発促進ならびに普及を目的として発足し、半導体デバイスメーカー、半導体製造装置メーカー、マスクメーカー、レジストメーカー計13社でスタートしました。その後13社が加わり、現在では4カ国26社になりました。

機は、量産用装置とほぼ同じ機能を持ち、半導体回路の転写実験ができる実証機で、LEEPL装置そのものの技術的課題は、ほぼクリアしています。現状、最大の課題と言われるものは、LEEPL用マスクの量産化です。LEEPL用マスクは、従来のガラスのマスクと全く異なるステンシルマスク(穴開きマスク)です。全てのマスクメーカーはLEEPL技術コンソーシアムに発足当時から加入されており、現在、技術的な問題はほぼクリアし、量産化に向けて活動中であり、LEEPL装置の出荷が本格化してくる時期までには、対応できる見込みです。

リソグラフィの世界市場規模は現在でも5,000億円以上あり、将来的には、一兆円規模になるとの予測があるほど大きな市場で、LEEPL装置の開発は、現在当社が最も注力している製品です。

QUESTION 4

今年4月より執行役員制とカンパニー制を導入されたと聞きました。この組織変更とコーポレートガバナンスについて教えてください。

ANSWER 4

当社は、2002年4月に執行役員制と社内カンパニー制を導入しました。社内カンパニー制は、社内を「半導体社」、「計測社」、「業務会社」の3つのカンパニーに分け、全ての業務をこの3社で行います。

「半導体社」と「計測社」は、完結した組織として、夫々のお客様に一層機動的かつ迅速に対応していきます。「業務会社」は、「半導体社」と「計測社」の間接部門を担当し、間接部門の合理化を推進していきます。

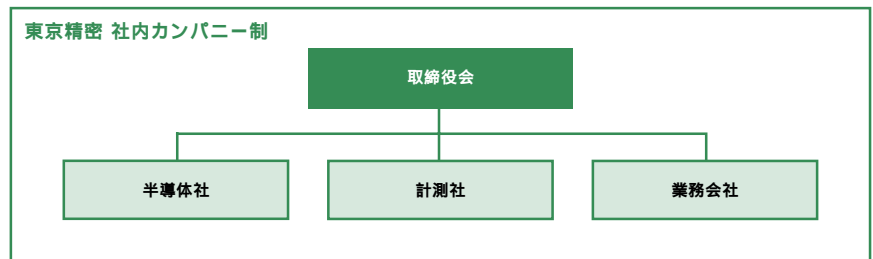
当社は、1988年より各技術開発グループを製品群別に分け、グループリーダーをヘッドとするグループリーダー制を採用してきました。グループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任を持ち、事業計画作成、開発・設備投資及び人材の採用など大きな権限を与えられてきました。社内カンパニー制の導入に伴い、各グループリーダーは、執行役員に選任されました。これにより、グループリーダー制の備えている開発計画などのスピーディーな意思決定や市場動向への迅速・柔軟な対応という長所が一層強化されました。

社内カンパニー制の導入に伴い、株式会社東京精密は、理論的には取締役会のみとなります。取締役会は、会社の重要な業務執行の決定や取締役の職務執行の監督を行う機関ですが、

当社の取締役は出身企業が多岐にわたり、様々な会社で経験を重ねた者が、取締役会を構成しており、当社の取締役会は、ハイブリッドな組織となっております。

当社の監査役は、当社の大株主出身の経営者で構成されています。当社監査役は、報酬委員会及び経営諮問委員会のメンバーを兼務し、役員の給与とその他、経営の妥当性の判断も行っていきます。

このように当社の取締役会及び監査役会のシステムは、日本、米国、ドイツのコーポレートガバナンスの長所をミックスした制度になっています。従って、当社のコーポレートガバナンスは、極めて透明性が高く、責任と権限の範囲が明確な組織になっています。



QUESTION 5

東京精密の株主価値向上及び利益配分についての基本的な考え方を教えてください。

ANSWER 5

当社は、企業として着実に成長していくことが株主価値の向上につながっていくと考えています。本質的な意味での株価や配当の上昇は、企業として着実に成長しなければ実現しないと考えています。そのため当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界No. 1の製品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図りたいと考えています。配当につきましては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、株主の皆様の長期的視点を重視した安定的な配当を実施していきたいと考えています。

当期は、厳しいビジネス状況下ではありますが30円の配当を継続することを決定しました。その理由は、2つあります。まず、半導体産業は、市況の急伸・急落があるので、短期の業績を直ちに配当に反映させることは、長期的視点で当社の株式を保有していただいている株主の皆様の視点に合致しません。また、当社の財務状況と今後のキャッシュフロー、及び平成14年3月末末処分利益92億64百万円から30円配当継続には無理がありません。

営業の概況

1. 当期の概況

業績全般

当期の半導体業界は、シリコンサイクルのボトムに、ITバブル崩壊に端を発した景気の全般的後退が重なり、さらに9月に米国で発生した同時多発テロの影響も加わって、需要の落込みが顕著で、低調に推移しました。しかし、年明け以降は、米国での在庫調整が進み、底打ち感が広がるとともに、米国やアジアなどを中心として需要回復の兆しが見え始めております。

当社は、このような状況下、営業努力を重ねて受注・売上の増強に努め、一方で生産面のコストダウンに注力いたしましたが、半導体メーカーの設備投資抑制の影響を避けられず、半導体製造機器部門の売上高・利益は、前期対比、減収・減益を余儀なくされました。

計測機器部門につきましても、全般的な景気低迷の下、各ユーザーの設備投資は低調でありました。当社は、測定部品の小型化・高精度化の顧客ニーズに対応するとともに、着実な営業努力とコストダウンを推進しましたが、計測機器部門についても、前期対比、減収・減益となりました。

この結果、当期の連結売上高は340億64百万円(前期比53.4%減)、連結経常損失は13億36百万円、連結当期損失は20億26百万円となりました。

各部門の概況

〔半導体製造用機器部門〕

厳しい半導体市況の下、各半導体メーカーのニーズに応えるきめ細かい営業を展開する一方、固定費削減、変動比率の引き下げなどの強力なコストダウン施策を推進しましたが、半導体業界の設備投資抑制の影響を受け、売上高は、206億7百万円(前期比64.8%減)、営業損失が、38億31百万円と

なりました。

しかし、下期に入り、ウェーハプロ - ビングマシンをはじめ、各製品とも引合い・受注が上向きに転じております。主力商品のウェーハプロ - ビングマシンでは、300mmウェーハ対応の高剛性を特徴とする最新鋭機種「UF300A」を開発し、販売を開始しました。お客様から高い支持を得ており、今後の販売増が見込まれます。ウェーハダイシングマシンにつきましても、300mm対応の「AWD300T」が生産性の高いマシンとして機能を高く評価され、売上が堅調に推移しております。

新製品のウェーハ外観検査装置「WINWIN50」とポリッシュ・グラインダ(ウェーハ裏面研磨装置)「PGシリーズ」も、着実に顧客層を拡大しております。また、CMP装置「AFP210A」につきましても、現在お客様にて評価中で、2002年度上期より、売上計上が見込まれます。

研究開発におきましては、300mm対応機種をはじめ、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に注力しております。

子会社の株式会社リープルが進めている100nm～35nmの微細回路製造用リソグラフィ装置「LEEPL」の開発も順調に進んでおり、本年3月に「LEEPL」機を、共同開発に参画されているソニー株式会社に出荷いたしました。また、昨年6月に、当社、株式会社リープル、ソニー株式会社の3社が、次世代リソグラフィ技術の開発促進並びに普及を目的にして、各業界に呼びかけて、「LEEPL技術コンソーシアム」を発足させました。当初、半導体デバイスメーカー、装置メーカー、マスクメーカー、レジストメーカーの13社で発足しましたが、その後加入企業が増加し、現在では26社が活動しています。

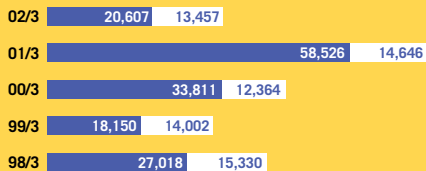
「LEEPL」は、次世代リソグラフィの本命として脚光を浴びておりますが、今後、コンソーシアムを中心に開発が一層加速され、リープル事業が当社のコア事業に成長していくものと予想されます。

また、当社は、LEEPL技術の開発・促進に必要な「電子ビームマスク用欠陥検査装置」につきましても、開発に着手しており、計画どおり順調に進捗しております。

〔計測機器部門〕

計測機器部門につきましても、需要が低迷するなかで、ユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力を行い、生産

連結部門別売上高



■ 半導体製造用機器 (百万円) □ 計測機器 (百万円)

面でも固定費の圧縮に努めました結果、売上高は、134億57百万円(前期比8.1%減)、営業利益は、20億73百万円となりました。

汎用計測機器では、世界最高精度を誇る表面粗さ測定機「サーフコム3000A」や高精度で好評の真円度測定機「ロンコムシリーズ」の売上が伸びました。また、自動計測機器では、「パルコムシリーズ」が流体軸受向けなどに好調に推移しました。

当社計測機器部門は、かねてより高い成長が期待される光通信関連の測定機器と検査機器を開発してまいりましたが、昨年9月に、当社とNTTアドバンステクノロジー株式会社が共同開発した光コネクタ端面自動傷検査装置「CEI-1000A」と、当社開発のフェルルル同心度測定機「FCM-5000A」を、新製品として販売開始いたしました。いずれの製品も、お客様の量産化や効率化に役立つ優れた特色を有しており、今後積極的に拡販してまいります。

連結キャッシュ・フローについて

当期のキャッシュ・フローは、営業・投資のキャッシュ・フローのマイナスを財務活動により補いましたが、今後は、新製品の売上拡大などにより、営業活動によるキャッシュ・フローの好転が見込まれ、投資活動も平準化することから、より良い財務状況を構築できる見込です。

株式会社東精エンジニアリングの上場

当社の連結子会社である株式会社東精エンジニアリングは、平成13年6月22日付で東京証券取引所市場第二部に株式上場いたしました。同社は、自動計測機器部門、半導体製造装置部門、計測サービス部門の三部門を展開し、当期(2002年3月期)の業績も堅調に推移いたしました。

2. 次期の見通し

2002年度の半導体市場は、通信市場の低迷や個人消費の伸び悩みなどの不透明要因があるものの、ITの発展に伴う社会的な構造変化が着実に進展し、国内外のIT投資は回復局面に入るものと予想されます。すでに年明け以降、在庫調整が一巡し底打ち感が強まるとともに、アジア、米国、欧州などで、需要回復の兆しが出ております。

半導体製造用機器につきましても、国内外の半導体メーカー等からの受注が、4月以降着実に回復し、売上・利益についても上期後半より向上していくものと予想されます。当社におきましても、マーケットシェアの高いウェーハプロービ

ングマシンやウェーハダイシングマシンなど既存製品に関し、受注・売上・利益の着実な回復が見込まれます。

それに加えて、次期より、ウェーハ外観検査装置・ポリッシュ・グラインダ・CMP装置などの新製品群が本格的に業績に寄与してまいりますので、当社は、業界水準を上回る業績を確保できるものと考えております。

当社は、需要増に備えた適切な生産体制を構築するとともに、様々な顧客ニーズに的確に 대응して、売上増強を図ってまいります。

以上より、半導体製造用機器部門の2002年度の連結売上高は、405億円(前期比96.5%増)を予想しております。

計測機器市場につきましては、国内全般景況の回復は緩やかで、工作機械メーカーをはじめとする各種メーカーの設備投資姿勢は引き続き慎重であると考えられます。かかる状況下ではありますが、次期の計測機器部門について、更なる営業努力、光通信関連新製品の拡販及び海外売上の増強などにより、前年とほぼ横這いの業績を計画し、2002年度の売上高は、135億円(前期比0.3%増)を予定しています。

以上のような予測の下、2002年度は、連結売上高540億円(前年同期比58.5%増)、連結経常利益23億円、連結当期純利益10億円と予想しております。

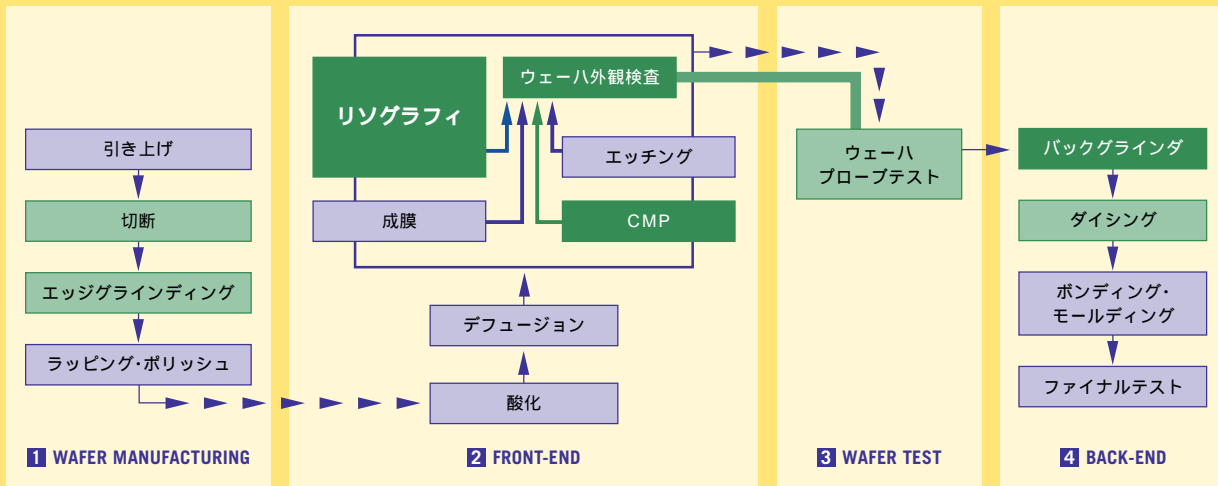
3. 会社の対処すべき課題

当社は、更なる躍進を目指し、半導体製造用機器部門における成長分野の市場に新たに参入すべく、近年新製品の開発に注力してまいりました。それらの新製品のうち、「ウェーハ外観検査装置」と「ポリッシュ・グラインダ(ウェーハ裏面研磨装置)」は着実に売上実績が積みあがっており、「CMP装置」等の新製品も含めて、今後さらに本格的に業績に寄与する予定です。また、次世代リソグラフィ技術の開発についても、2001年6月に「LEEPL技術コンソーシアム」を発足させ、2002年3月には「LEEPL転写装置」の機をソニー株式会社に出荷する等、順調に進んでいます。

当社は、上記新製品群の開発促進による業績貢献と、「高品質・高効率な製品の生産」を可能にするより高度な生産システムの構築により、営業基盤の更なる強化と収益体質の確立を目指します。

東京精密の半導体製造装置

半導体製造工程



当社が製造・販売している半導体製造装置は、上記の半導体製造工程図の中で、緑色の工程で使用されている装置です（内、■が既存製品群で■が新製品群）。

上記の半導体製造工程 **1** の部分は、ウェーハ製造工程で、ウェーハメーカーがお客様です。当社は、半導体の基となるシリコン単結晶インゴットをスライスしてウェーハと呼ばれるシリコン基板を切り出す装置（ワイヤーソー、スライサー）とウェーハ周辺部の面取りをするエッジラインダーを販売しています。

2 のFRONT-ENDから **4** のBACK-ENDまでが、半導体デバイスを製造する工程で、半導体メーカーがお客様です。**2** のFRONT-END（前工程）はウェーハプロセスとも呼ばれ、半導体製造の中心となる部分で、半導体メーカーの設備投資額全体の70%以上がこの部分に投資されます。リソグラフィは、半導体回路のパターンをウェーハ上に転写する前工程の中核となる装置です。ウェーハ外観検査装置は、回路パターンが転写されたウェーハ表面の異物・パターン欠陥等を検出する装置であり、CMPは、ウェーハ表面を平坦化する装置です。

3 のWAFER TEST工程は、ウェーハ上に形成された多数のデバイスの電気特性を全数検査する工程で、ウェーハプローブテストと呼ばれ、当社のプローバはこの工程で使用されています。

4 のBACK-END（後工程）は、組立てと最終試験工程です。当社は、ウェーハの裏面を研磨するバックグラインディングプロセスで、世界で唯一ウェーハの薄片化とダメージ除去を一台の装置で実現するポリッシュ・グラインダを製造・販売しています。さらに、ウェーハ上に形成された多数のデバイスを一個一個のデバイス（チップ）に切断するダイシング工程で使用されるダイサーを製造・販売しています。

連結貸借対照表

単位:千円

勘定科目	第78期	第79期	勘定科目	第78期	第79期
	(01.03.31)	(02.03.31)		(01.03.31)	(02.03.31)
	金額	金額		金額	金額
流動資産	69,043,723	53,234,688	流動負債	43,136,614	31,227,779
現金及び預金	6,990,699	5,924,839	支払手形及び買掛金	21,253,111	5,242,271
受取手形及び売掛金	27,253,135	12,156,017	短期借入金	11,120,000	22,815,711
たな卸資産	32,315,814	34,127,962	一年以内に返済する長期借入金	205,592	264,140
未収消費税等	807,069	104,664	未払法人税等	4,862,608	296,001
繰延税金資産	1,186,646	298,553	賞与引当金	1,023,531	608,371
その他	567,918	658,853	その他	4,671,769	2,001,283
貸倒引当金	77,560	36,203			
固定資産	22,433,053	26,630,548	固定負債	9,256,673	11,448,964
(有形固定資産)	(11,243,858)	(13,849,018)	社債	250,000	250,000
建物及び構築物	6,460,170	6,041,340	転換社債	53,000	51,000
機械装置及び運搬具	2,348,008	3,223,439	長期借入金	5,894,184	7,765,010
工具器具備品	792,714	823,470	退職給付引当金	2,812,431	2,794,371
土地	805,337	2,916,779	役員退職慰労引当金	247,058	540,852
建設仮勘定	837,626	843,988	繰延税金負債		47,729
(無形固定資産)	(6,566,636)	(6,358,475)	負債合計	52,393,287	42,676,743
ソフトウェア	6,419,901	6,200,391			
その他	146,734	158,084	少数株主持分	304,509	1,764,889
(投資その他の資産)	(4,622,559)	(6,423,055)			
投資有価証券	2,853,302	2,853,440	資本		
長期貸付金	173,238	100,442	資本金	7,014,022	7,199,991
繰延税金資産	1,120,487	2,858,359	資本準備金	11,591,203	11,806,740
その他	520,209	702,125	連結剰余金	20,401,599	16,463,548
貸倒引当金	44,678	91,313	その他有価証券評価差額金	250,830	244,060
			為替換算調整勘定	23,759	208,331
繰延資産	367	125	自己株式	407	10,822
社債発行差金	367	125	資本合計	38,779,347	35,423,729
資産合計	91,477,144	79,865,363	負債、少数株主持分及び資本合計	91,477,144	79,865,363

連結損益計算書

単位:千円

	第78期(00.04.01～01.03.31)		第79期(01.04.01～02.03.31)	
	金額		金額	
売上高		73,172,461		34,064,888
売上原価		45,375,417		24,460,178
売上総利益		27,797,044		9,604,710
販売費及び一般管理費				
販売費	9,612,934		7,856,914	
一般管理費	3,151,640	12,764,575	3,505,344	11,362,259
営業利益(損失)		15,032,468		1,757,548
営業外収益				
受取利息	60,405		25,174	
受取配当金	77,880		98,924	
その他	214,728	353,014	648,703	772,803
営業外費用				
支払利息	167,147		218,828	
その他	544,043	711,191	132,892	351,720
経常利益(損失)		14,674,292		1,336,466
特別利益				
退職給付信託設定益	1,732,091			
連結子会社株式売却益			1,902,046	
その他	93,260	1,825,351	2,400	1,904,446
特別損失				
退職給付引当金繰入額	2,837,331			
たな卸資産評価損及び廃却損	45,323		1,779,682	
その他	513,426	3,396,080	887,985	2,667,667
税金等調整前当期利益(損失)		13,103,563		2,099,687
法人税、住民税及び事業税	6,820,980		600,217	
法人税等調整額	1,017,303	5,803,677	821,314	221,096
少数株主利益		62,216		147,445
連結当期利益(損失)		7,237,669		2,026,036

連結剰余金計算書

単位:千円

	第78期(00.04.01～01.03.31)		第79期(01.04.01～02.03.31)	
	金額		金額	
連結剰余金期首残高		14,836,704		20,401,599
連結剰余金減少高				
1.配当金	919,537		1,121,091	
2.取締役賞与金	64,890		64,890	
3.自己株式消却額	688,346	1,672,773	726,033	1,912,014
当期利益(損失)		7,237,669		2,026,036
連結剰余金期末残高		20,401,599		16,463,548

連結キャッシュ・フロー計算書

単位:千円

	第78期	第79期
	(00.04.01-01.03.31)	(01.04.01-02.03.31)
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期利益(損失)	13,103,563	2,099,687
減価償却費	1,567,207	1,860,767
退職給付引当金の増減額	26,016	18,059
退職給付信託設定に伴う その他有価証券の減少額	998,069	
役員退職慰労引当金の増減額	64,610	293,794
受取利息及び受取配当金	138,285	124,099
支払利息	211,686	253,084
投資有価証券売却益	22,760	
連結子会社株式売却益		1,902,046
有形固定資産除却・売却損	8,664	34,794
有価証券・ゴルフ会員権評価損	414,262	639,270
たな卸資産評価損及び廃却損	45,323	1,779,682
売上債権の増減額	10,592,331	15,389,767
たな卸資産の増加額	13,640,381	3,040,922
販売用ソフトウェアの増減額	2,550,612	172,330
仕入債務の増減額	7,930,838	16,486,121
取締役賞与の支払額	64,890	64,890
その他営業活動による収入(支出)	873,046	914,144
小計	1,895,193	4,226,479
利息及び配当金受取額	139,122	124,099
利息の支払額	211,686	270,241
法人税等の支払額	5,555,072	5,195,544
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,522,829	9,568,166

	第78期	第79期
	(00.04.01-01.03.31)	(01.04.01-02.03.31)
	金額	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	204,835	187,004
定期預金の払出による収入	170,000	364,840
投資有価証券の取得による支出	594,963	604,476
投資有価証券の売却による収入	40,747	
連結子会社株式の売却による収入		1,861,200
有形・無形固定資産の 取得による支出	3,095,326	6,492,267
有形固定資産の売却による収入	146,064	7,211
貸付金の実行による支出	888	9,500
貸付金の回収による収入	53,664	82,296
その他投資活動による収入(支出)	12,402	
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,497,940	4,977,701
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(純額)	10,731,000	11,695,711
長期借入れによる収入	3,000,000	2,200,000
長期借入金の返済による支出	537,676	272,000
連結子会社の増資による収入		1,353,600
新株引受権の権利行使による収入		369,908
社債の発行による収入		190,000
社債の償還による支出		105,001
自己株式の消却による支出	688,346	726,033
配当金の支払による支出	919,537	1,121,091
その他財務活動による収入(支出)	2,968	10,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,588,408	13,574,675
現金及び現金同等物に係る換算差額	13,890	83,168
現金及び現金同等物の増減額	553,748	888,023
現金及び現金同等物の期首残高	6,232,115	6,785,863
現金及び現金同等物の期末残高	6,785,863	5,897,839

貸借対照表(単独決算)

単位:千円

勘定科目	第78期	第79期	勘定科目	第78期	第79期
	(01.03.31)	(02.03.31)		(01.03.31)	(02.03.31)
	金額	金額		金額	金額
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	62,773,327	48,068,340	流動負債	39,817,531	30,477,759
現金及び預金	3,863,088	3,946,931	支払手形	15,554,378	4,731,659
受取手形	1,237,134	681,015	買掛金	5,654,348	1,868,040
売掛金	26,851,103	12,854,348	短期借入金	10,000,000	22,000,000
たな卸資産	26,170,417	26,392,457	未払金	2,740,340	566,942
未収消費税等	796,466	143,542	未払法人税等	3,841,028	20,410
繰延税金資産	802,304	201,828	賞与引当金	727,205	400,050
その他	3,060,712	3,854,695	その他	1,300,229	890,657
貸倒引当金	7,901	6,479			
固定資産	21,991,374	26,054,432	固定負債	7,874,345	9,900,797
(有形固定資産)	(7,952,970)	(9,608,531)	社債	5,400,000	7,200,000
建物及び構築物	4,595,483	4,355,114	転換社債	53,000	51,000
機械装置	1,622,721	2,377,652	退職給付引当金	2,230,730	2,176,496
土地	433,706	1,528,421	役員退職慰労引当金	190,615	473,301
その他	663,683	618,388	負債合計	47,691,876	40,378,557
建設仮勘定	637,374	728,954			
(無形固定資産)	(6,448,751)	(6,233,956)	(資本の部)		
ソフトウェア	6,410,060	6,190,439	資本金	7,014,022	7,199,991
その他	38,690	43,517	法定準備金	12,259,059	12,535,295
(投資等)	(7,589,652)	(10,211,943)	資本準備金	11,591,203	11,806,740
投資有価証券	2,764,926	2,273,846	利益準備金	667,855	728,554
子会社株式	3,195,803	3,877,046	剰余金	18,067,611	14,264,765
長期貸付金	167,496	887,317	別途積立金	5,000,000	5,000,000
繰延税金資産	998,927	2,656,786	当期末処分利益	13,067,611	9,264,765
その他	498,618	597,225	(うち当期利益)	(6,688,853)	(1,850,023)
貸倒引当金	36,119	80,278	その他有価証券評価差額金	244,535	237,014
繰延資産	23,333	8,000	自己株式		10,822
社債発行差金	23,333	8,000	資本合計	37,096,158	33,752,215
資産合計	84,788,035	74,130,772	負債及び資本合計	84,788,035	74,130,772

(注) 1. 子会社に対する短期金銭債権
2. 子会社に対する短期金銭債務
3. 子会社に対する長期金銭債権
4. 子会社に対する長期金銭債務
5. 主な外貨建資産

売掛金 3,568,532千円
子会社株式 2,500,996千円

5,437,411千円

2,800,926千円

824,075千円

7,200,000千円

6. 自己株式数

7. 有形固定資産の減価償却累計額

8. 債務保証及び保証類似行為

9. 受取手形割引高

10. 役員退職慰労引当金は高法第287条ノ2の引当金であります。

2,350株

7,581,161千円

407,950千円

2,229,766千円

損益計算書(単独決算)

勘定科目	第78期 (00.04.01 - 01.03.31)		第79期 (01.04.01 - 02.03.31)	
	内訳	合計	内訳	合計
売上高		64,423,655		27,643,807
売上原価		43,752,690		21,955,718
売上総利益		20,670,964		5,688,089
販売費及び一般管理費				
販売費	6,431,406		5,329,953	
一般管理費	2,108,563	8,539,970	2,663,024	7,992,978
営業利益(損失)		12,130,994		2,304,888
営業外収益				
受取利息及び配当金	330,232		455,878	
その他	782,774	1,113,007	245,749	701,627
営業外費用				
支払利息	184,999		254,079	
その他	116,080	301,080	111,293	365,373
経常利益(損失)		12,942,921		1,968,634
特別利益				
退職給付信託設定益	1,732,091		1,793,737	
子会社株式売却益			2,400	
その他	87,894	1,819,985		1,796,137
特別損失				
退職給付引当金繰入額	2,629,078			
たな卸資産評価損及び廃却損	45,323		1,779,682	
その他	513,426	3,187,828	863,632	2,643,314
税引前当期利益(損失)		11,575,079		2,815,811
法人税、住民税及び事業税	5,562,852		97,051	
法人税等調整額	676,626	4,886,225	1,062,840	965,788
当期利益(損失)		6,688,853		1,850,023
前期繰越利益		7,686,268		12,399,927
自己株式消却額		688,346		726,033
中間配当額		562,876		559,105
利益準備金積立額		56,287		
当期末処分利益		13,067,611		9,264,765

(注)子会社との取引高

(1)売上高	4,955,218千円
(2)仕入高	8,547,788千円
(3)営業取引以外の取引高	137,924千円

利益処分

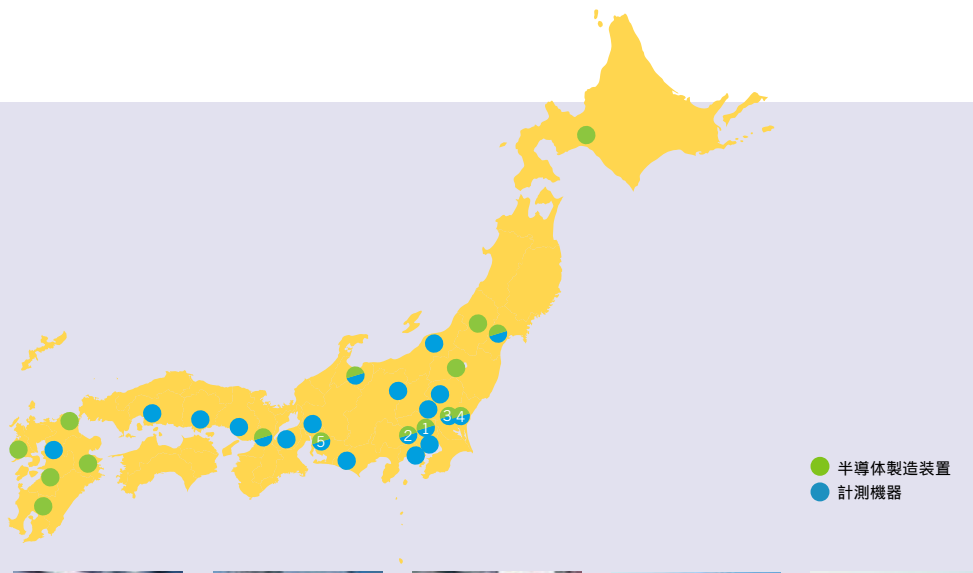
単位:千円

項目	第78期 (01.03.31)		第79期 (02.03.31)	
	内訳	合計	内訳	合計
当期末処分利益		13,067,611		9,264,765
利益処分数額				
利益準備金	60,699			
配当金	561,985		560,559	
取締役賞与金	45,000	667,684		560,559
次期繰越利益		12,399,927		8,704,205

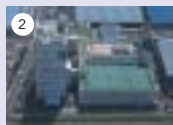
(注)平成12年12月1日に562,876千円(1株につき15円)の中間配当を実施いたしました。

ネットワーク

国内主要拠点



1 本社(業務会社)



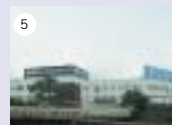
2 八王子工場(半導体社)
株式会社エスケイマイクロテクノロジ



3 土浦工場(計測社)

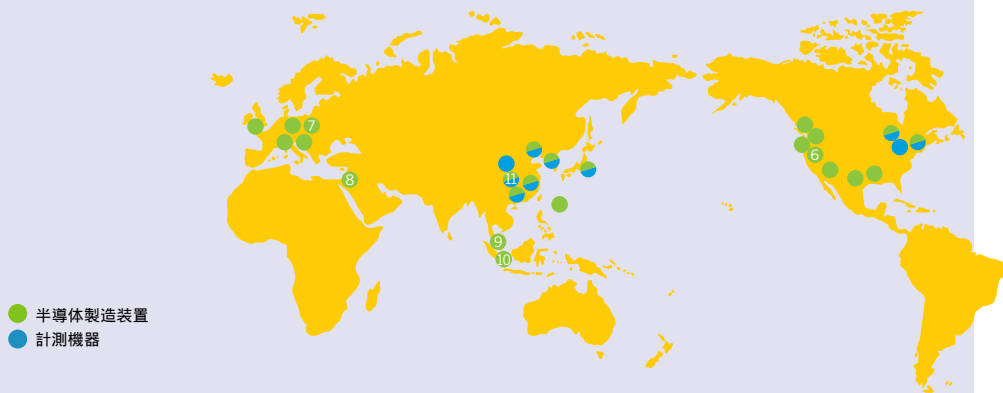


4 倅東精エンジニアリング
本社・工場



5 倅東精エンジニアリング
名古屋工場

海外拠点



6 Accretech USA, Inc.



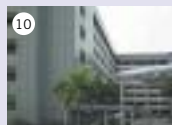
7 Tokyo Seimitsu
Europe GmbH



8 Tokyo Seimitsu
(Israel)Ltd.



9 Tokyo Seimitsu
(Malaysia)Sdn. Bhd.



10 Tokyo Seimitsu
(Singapore)Pte. Ltd.



11 東精精密設備
(上海)有限公司

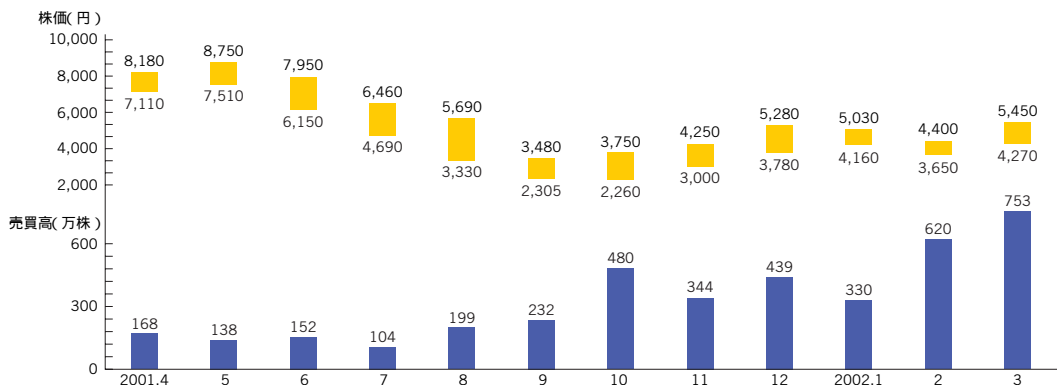
会社の概況 (平成14年3月31日現在)

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	事業所	本社 技術研究所 工場	東京都三鷹市 東京都八王子市 八王子(東京都八王子市) 土浦(茨城県土浦市)
設立 資本金 証券取引所 役員	昭和24年3月28日 7,199,991,430円 東京証券取引所 市場第一部	営業所	東北(宮城県仙台市) 山形(山形県山形市) 茨城(茨城県土浦市) 宇都宮(栃木県宇都宮市) 埼玉(埼玉県さいたま市) 東京(東京都三鷹市) 販売 一課、二課、三課 (東京都八王子市) 西東京(東京都八王子市) 川崎(神奈川県川崎市) 新潟(新潟県分水町) 厚木(神奈川県厚木市) 北陸(富山県富山市) (注) :全製品取扱 :半導体製品取扱 無印:計測・自動計測製品取扱	長野(長野県岡谷市) 浜松(静岡県浜松市) 名古屋(愛知県三好町) 小牧(愛知県西春町) 京滋(滋賀県守山市) 大阪(大阪府吹田市) 加古川(兵庫県加古川市) 岡山(岡山県岡山市) 広島(広島県広島市) 九州(福岡県久留米市) 九州(大分県大分市)
代表取締役会長兼社長 Chairman & C.E.O.	大坪 英夫	国内子会社	株式会社 東精エンジニアリング 株式会社 ティーエスケイ・マイクロテクノロジー 株式会社 トーセシステムズ 株式会社 東精クリエイト 株式会社 ティーエスケイ・ファイナンス 株式会社 リープル 株式会社 東精ボックス	
代表取締役 米国代表	鴻田 道明	海外子会社	Accretech USA, Inc. Tokyo Seimitsu Europe GmbH Tokyo Seimitsu (Malaysia) Sdn. Bhd. Tokyo Seimitsu (Israel) Ltd. Tokyo Seimitsu (Singapore) Pte. Ltd. TSK MICRO TECHNOLOGIES KOREA CO., LTD 東精精密設備(上海)有限公司	
代表取締役 C.O.O. 半導体社担当	鈴木 貞勝	海外関連会社	三門峡中原精密有限責任公司	
代表取締役 C.T.O. 企画担当	薫 清昭			
代表取締役 C.O.O. 業務会社担当	西嶋 尚生			
取締役	高城 英明			
取締役	林 和博			
監査役(常勤)	輕部 昭三郎			
監査役	坂田 耕四郎			
監査役	野口 光			
従業員数	650名			
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行 UFJ信託銀行 三井住友銀行 あさひ銀行 東京三菱銀行 常陽銀行 関東銀行	大手町営業第二部 東京第一営業部 本店法人営業第一部 吉祥寺支店 新宿中央支社 土浦支店 本店営業部		

株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月中 基準日毎年3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
名義書換代理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話(03)5683-5111(代表)
同取次所	UFJ信託銀行株式会社
株式取扱手数料	名義書換 無料 新株券交付 無料
公告掲載新聞	東京都において発行される日本経済新聞

株価の推移 (平成14年3月31日現在)



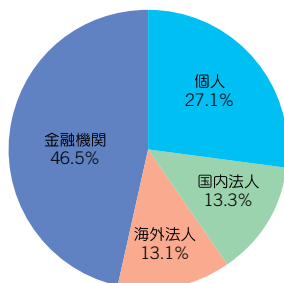
年・月	2001.4	5	6	7	8	9	10	11	12	2002.1	2	3
高値(円)	8,180	8,750	7,950	6,460	5,690	3,480	3,750	4,250	5,280	5,030	4,400	5,450
安値(円)	7,110	7,510	6,150	4,690	3,330	2,305	2,260	3,000	3,780	4,160	3,650	4,270
売買高(万株)	168	138	152	104	199	232	480	344	439	330	620	753

株式の状況 (平成14年3月31日現在)

会社が発行する株式の総数	110,501,100株
発行済株式の総数	37,372,993株
当期中の増減	
転換社債の転換による新株式発行	1,096株
新株引受権行使による新株式発行	99,126株
利益による自己株式の消却	193,000株

株主数 23,554名

所有者別状況



大株主

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
UFJ 信託銀行株式会社	2,899	7.8
三菱信託銀行株式会社(信託口)	2,438	6.5
野村信託銀行株式会社(投信口)	2,182	5.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,104	5.6
株式会社富士銀行	1,608	4.3
日本精工株式会社	1,313	3.5
三井生命保険相互会社	1,100	2.9
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.8
安田火災海上保険株式会社	1,000	2.7
高城 ヒデ子	808	2.1

UFJ信託銀行株式会社の持株数には、信託業務分1,381千株が含まれております。

株主の皆様へ アンケートのお願い

弊社では、株主の皆様の声を経営に反映させるべく、アンケートを実施させていただきます。お手数ではございますが、アンケートの質問事項をお読みいただき、回答をご記入の上、ご投函下さい。

皆様のご協力をお願い申し上げます。

弊社資料請求について

弊社資料をご希望の場合は、アンケート用紙の資料請求欄にご記入の上、ご投函下さい。

見通しに関する注意事項

この事業報告書に掲載されている東京精密の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実ではない事柄は、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。リスクや不確実性には、世界経済の動向、当社の事業領域の市況、為替変動、急速な技術革新による競争の激化などがあります。このような事象により、実際の業績はこれら見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。



- キリトリ線 -

株主の皆様へ アンケートのお願い

1. 弊社の株式をご購入された理由は何でしょうか？

- 1) 将来性 2) 収益性 3) 経営理念 4) 事業内容 5) 証券会社に勧められて
6) その他()

2. 今後の弊社株式についてどのような方針をお持ちですか？

- 1) 買い増し 2) 保有 3) 売却

また、上記方針を決定するための判断材料は何ですか？

- 1) 株価 2) 配当 3) 将来計画 4) 業績 5) その他()

3. 今回の事業報告書で興味を持たれた記事はどれでしょうか？

- 1) 株主の皆様へ 2) Q&A 3) 営業の概況 4) 東京精密の半導体製造装置
5) 財務データ 6) その他()

4. 今後事業報告書で取り上げて欲しいテーマをお聞かせ下さい。

()

5. 株式投資歴をお聞かせ下さい。

- 1) 3年未満 2) 3年以上10年未満 3) 10年以上20年未満 4) 20年以上

6. 所有株式数をお聞かせ下さい。

- 1) 100株 2) 200株以上 3) 500株以上 4) 1,000株以上 5) 5,000株以上

7. 弊社株式保有歴をお聞かせ下さい。

- 1) 1年未満 2) 1年以上 3) 3年以上 4) その他()

8. その他、弊社に対するご意見・ご希望があればお願いいたします。

()

資料請求(ご希望の資料に丸印をお願いします)

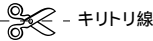
- 1) 会社概要 2) 和文版アニュアルレポート 3) 英文版アニュアルレポート
4) LEEPL社 会社案内

ご住所 〒

お名前

男性・女性

年齢



キリトリ線

郵便はがき

料金受取人払

三鷹局承認

199

差出有効期限
平成14年10月
31日まで

1 8 1 8 7 9 0

東京都三鷹市下連雀9-7-1

株式会社 東京精密
業務会社 総務室 宛



東京精密ホームページ

→ <http://www.accretech.jp>



「投資家の皆様へ」をクリック



IRホームページ

→ <http://www.accretech.jp/contents/ir.html>

最新のプレスリリース掲載

アニュアルレポート、事業報告書等
各種IRツールのダウンロードが可能
な充実したIRライブラリー

決算短信、主要財務指標掲載

決算説明会の状況をオンデマンド
配信(決算説明会后3ヶ月間)

TOKYO SEIMITSU
<http://www.accretech.jp>